



次世代構造部材創製・加工技術開発シンポジウム

一次世代チタン合金構造部材創製・加工技術開発／複合材構造健全性診断技術開発 開催のご案内



主催：一般財団法人 素形材センター 次世代材料技術室

(一財)素形材センターは、平成20年度より経済産業省から委託された次世代構造部材創製・加工技術開発に関する2つの研究を実施しています。一つは将来の航空機構造への適用が期待されるチタン合金の材料・プロセス技術の開発、他方は複合材構造健全性診断技術の航空機構造への適用技術の開発であり、両者とも平成24年度末を持って終了します。

この度、本成果報告につきまして、下記プログラムによるシンポジウムを企画いたしました。つきましては、ご多忙中とは存じますが、航空機産業の皆様のみならず、自動車、電気機器等のユーザ産業の皆様におかれましても、新規部品開拓等のご参考になるものと存じますので、多数ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

Ⅰ 開催概要

■ と き 平成25年2月25日(月) 13:10~16:50

(受付開始: 12:30)

■ ところ 機械振興会館 6階 6D-4会議室 (東京都港区芝公園3丁目5番8号) (案内図参照)

Ⅱ プログラム

挨拶	-----	13:10~13:15
	(一財)素形材センター 次世代材料技術室長	君島 孝尚
(1)複合材構造健全性診断技術開発成果報告	司会 (一財)素形材センター	榎本 清志
1.複合材構造健全性診断技術開発の概要	-----	13:15~13:25
	(一財)素形材センター	吉田 幹夫
2.光相関ブリルアン散乱計測法による航空機構造健全性診断技術の開発	-----	13:25~13:40
	三菱重工業(株)	斉藤 望
3.光ファイバセンサによる航空機構造衝撃損傷検知システム技術の開発	-----	13:40~13:55
	川崎重工業(株)	平野 憲芳
4.FBG/PZT ハイブリッドシステムによる航空機構造の損傷モニタリング技術の開発	-----	13:55~14:10
	富士重工業(株)	高橋 孝平
5.ライフサイクルを通じたストレインマッピングによる構造健全性診断技術の開発	-----	14:10~14:25
	三菱電機(株)	高橋 市弥
(2)講演: SHM の実用化と複合材革新成形技術の構築を目指して	-----	14:25~14:55
	(プロジェクトリーダー) 東京大学	武田 展雄
***** (休憩 14:55~15:15) *****		
(3)次世代チタン合金構造部材創製・加工技術開発成果報告	司会 (一財)素形材センター	吉田 幹夫
1.次世代チタン合金構造部材創製・加工技術開発の概要	-----	15:15~15:35
	(一財)素形材センター	磯江 暁
2.チタン板金部品の低コスト製造技術の開発	-----	15:35~15:50
	三菱重工業(株)	佐藤 広明
3.高加工性新チタン合金の押出／鍛造材を用いた低コスト製造技術の開発	-----	15:50~16:05
	川崎重工業(株)	浅井 康司
4.高機能化チタン合金焼結部品の低コスト製造技術の開発	-----	16:05~16:20
	富士重工業(株)	坂部 敦彦
(4)講演: チタン合金の研究開発の方向性	-----	16:20~16:50
	(プロジェクトリーダー) 東北大学	新家 光雄

なお、シンポジウム終了後、交流会を準備しています。シンポジウムでの話題に関する意見交換もできますので、奮ってご参加ください。

参加要領

- 定員 60名 (申込順に受け付け、定員になり次第締め切ります)
- 参加費 (シンポジウム) 無料
(交流会) 3,000円 (消費税込み)



■ 申込方法、お問い合わせ先

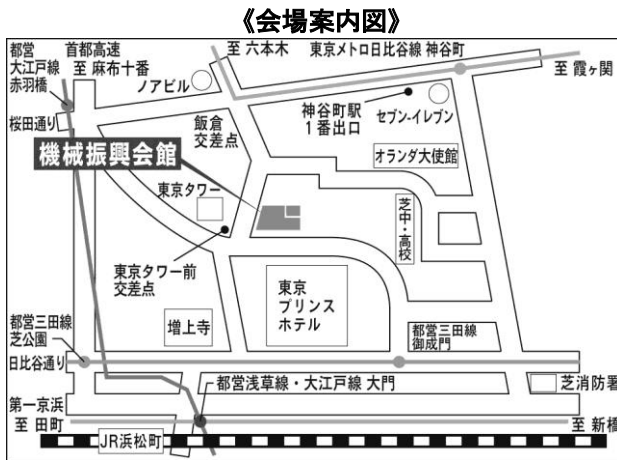
下記申込書に所要事項記入の上、郵送もしくはFAX、E-mailでお申込み下さい。申し込み受付はE-mail宛にご連絡いたします。

〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号 機械振興会館3階301号室
 一般財団法人 素形材センター 次世代材料技術室 航空機材料技術部 (担当: 磯江)
 電話: 03(3459)6900 FAX: 03(3459)6911 E-mail: rimcof-symposium@sokeizai.or.jp

■ 参加費のお支払い

参加申込後、別途ご請求させていただきます(領収書を必要とされる場合は、申込書の□に✓してください)
 (振込み手数料は、ご負担願います)

■ 申込締切 平成25年2月12日(火)



地下鉄: 東京メトロ日比谷線神谷町駅下車(徒歩8分), 都営三田線御成門駅下車(徒歩10分), 都営大江戸線赤羽橋駅下車(徒歩10分), 都営浅草線大門駅下車(徒歩15分)

JR: 浜松町駅下車(徒歩17分)

バス: 浜松町~東京タワー路線東京タワー前下車

個人情報保護法に関する対応

ご記入頂いた個人情報は、本シンポジウムの事務に利用するとともに、参加者リストを作成し、講師にお渡しします。

今後、素形材センターが行う素形材産業の実情に関する調査アンケートへの協力依頼を行う場合もあります。

(※ 会場では、一切の録音、録画をお断りします。予めご了承下さい。)

申 込 書

(一財)素形材センター 次世代材料技術室 航空機材料技術部 宛

次世代構造部材創製・加工技術開発シンポジウム

(平成25年2月25日開催)

機関名		部署名	
住所	〒		
TEL/FAX		E-mail	
参加者氏名			
シンポジウム (無料)		交流会 (有料: 3,000円/人)	
参加 ・ 不参加		参加 ・ 不参加 □ 領収書	

金額 _____ 円也、上記のとおり参加いたしますので、申し込みます。

年 月 日